



1. * Размеры для справок.
2. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91. Элементы установить: поз. 8, 19, 21, 23, 26, 52, 54, 55, 60, 61 - по чертежу; поз. 20 - по варианту 361.18.1105.12.00; поз. 24 - по варианту 361.18.1108.00.00; поз. 25 - по варианту 361.18.1103.00.00; поз. 53 - по варианту 14.0.0.2.0202.00.00.
3. Паять припоем ПОССу 61-0.5 или ПОС 61 ГОСТ 21930-76. Чип компоненты паять паяльной пастой серии 7140 по ТУ 029-00387275-2014.
4. Микросхемы поз. 20, 24, 25, резисторы поз. 50, 51, прокладки поз. 62, 64, подставка поз. 4 ставить на клей ВК-9 или ВК-53М (режим сушки 2) по ОСТ 1 80215-84. Не допускается попадание клея в металлизированные отверстия (контактных площадок элементов).
5. Программирование микросхемы поз. 24 и проверку платы производить согласно 9М6.673.175И.
6. Перед покрытием платы лаком нанести по контуру на основание разъемов XP3, XP4, XP5 герметик эластосил Т37-182 ТУ 6-02-1-015-89.
7. Покрытие платы: лак УР-231 способ ОЗ или Р2 по ОСТ 1 80365-82, кроме поз. 56, 60.
8. Маркировать месяц, год, порядковый номер платы на свободном месте эмалью ЭП-572 черной по ОСТ 1 90210-85.
9. Клейма ОТК выполнять эмалью ЭП-572 черной по ОСТ 1 90210-85.
10. Маркировка элементов дана условно и соответствует 9М6.673.17533.
11. FD1, FD6 - реперные знаки.

9М6.673.175СБ					Лит			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит			Масса	Масштаб
Разработ	Качалова				а			2.5:1	
Проб	Кузнецов								
Т. контр.	Шажин								
Н. контр.	Халикова								
Умб.	Шажин								
Копировать					Формат А1				